

國立中興大學技術授權遴選廠商公告資料表

公告主旨：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	公告日期：108/05/06
公告編號：108-021	
內容：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告 一、技術名稱(Know-How)：化學鍍銅的前處理方法及其使用的銅離子錯合物觸媒溶液及調節液 二、專利資訊：中華民國專利證號 I 626989 三、技術來源：本校研發成果 四、技術內容： 化學鍍銅(俗稱無電電鍍銅)，歷經60多年的歷史，至今依然使用鈀金屬當作催化劑，讓非導體變成導體。如今鈀金屬的價格已經高於黃金，導致相關產業成本高漲，淪為名符其實的「慘業」。此技術以離子銅當作觸媒的前區物，取代昂貴的鈀觸媒，可大幅降低製程成本。	
五、計畫執行機關/系所：化學工程學系 技術發明人：竇維平教授、張弘明、蔡耀麟、劉祖啟	
六、廠商資格： 1、廠商業別：晶片封裝廠、特用化學供應商、電路板廠、塑膠電鍍廠 2、應具備之專門技術：化學及電化學背景 3、應有之機具設備：電鍍設備 4、應有之研究或技術人員人數：2~3人 5、其他：無	
七、預期利用範圍及產品：晶片電鍍、電路板電鍍、塑膠電鍍	
八、公開方式： (一) 技術資料於網際網路上公開。 網址：國立中興大學首頁 http://www.nchu.edu.tw/index1.php 國立中興大學產學研鏈結中心 http://140.120.49.189/about1.php (二) 逕向國立中興大學產學研鏈結中心葉小姐及黃小姐索取相關資料。	
九、申請方式： (一) 由網際網路下載申請表格，填妥後逕送至國立中興大學產學研鏈結中心。 (二) 亦得逕至中興大學索取技術資料及申請表格， 地點：台中市興大路145號(國農中心大樓2F 234室) 承辦人員：葉小姐/黃小姐 聯絡電話：(04)22851811#21.20 傳真：(04)22851672 e-mail： jmine3388@nchu.edu.tw 、 yenling@nchu.edu.tw	